

半導体関連事業説明会

The AGC logo is displayed in a white rectangular box on the right side of the slide. It consists of the letters 'AGC' in a bold, blue, sans-serif font, with a small red square positioned above the letter 'C'.

AGC株式会社

2026年6月2日

Your Dreams, Our Challenge



AGCグループの技術開発戦略と半導体関連事業 ————— p. 3

半導体関連事業：

エレクトロニクス ————— p. 14

パフォーマンスケミカルズ ————— p. 23

まとめ ————— p. 36

AGCグループの技術開発戦略と半導体関連事業

創業時の志

受け継がれている思い



現在

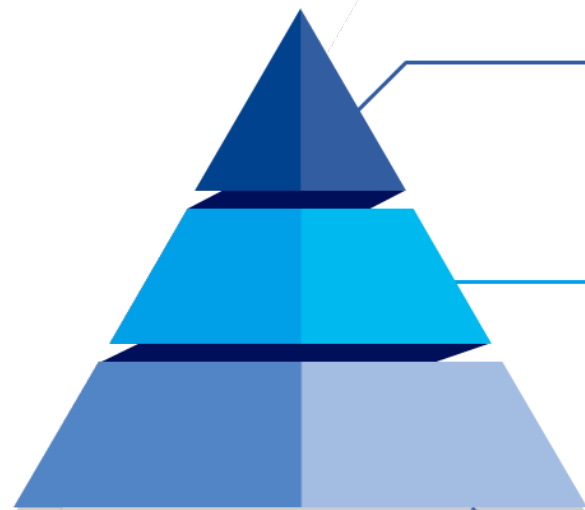
板ガラスの
国産化を通じて
社会の発展に貢献したい



創業者 岩崎俊彌

困難は覚悟の上で
難題に挑む

“Look Beyond”



私たちの
パーパス

私たちの
価値観

私たちの
スピリット

“AGC、いつも世界の大事な一部”

～ 私たちは先を見据え、独自の素材・ソリューションで、
いつもどこかで世界中の人々の暮らしを支えます～

- Innovation & Operational Excellence
- Sustainability for a Blue Planet
- One Team with Diversity
- Integrity & Trust

“易きになじまず難きにつく”

AGCグループの製品・サービスの時代変遷

■ 創業の精神を体現し、それぞれの時代が求める素材・ソリューションを提供し続けてきた



建設ラッシュ
(日本)



第一次
世界大戦

モータリゼーション・
テレビ時代の到来



環境・健康への
意識の高まり



バイオテクノロジーの
発展



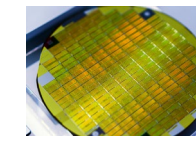
デジタル・通信
技術の進化



創薬モダリティの
多様化



IoT時代の
本格到来



次世代半導体・
高速通信

1907年

1910年代

1950年代

1970年代

1990年代

2000年代

2010年代

2020年代



旭硝子創業
建築用板ガラス

ガラス溶解窯用
耐火煉瓦
(セラミックス事業へ)



ガラス原料用
ソーダ灰
(化学品事業へ)



自動車用ガラス



TVブラウン管用
ガラスバルブ



苛性ソーダ製造用
イオン交換膜



合成医薬中間体



液晶ディスプレイ用
無アルカリガラス



オゾン層を破壊しない
代替フロン



デジタルカメラ用
色調補正
ガラスフィルター



バイオ医薬品CDMO



半導体プロセス用
CMPスラリー



車載ディスプレイ用
カバーガラス



スマートフォン用
化学強化ガラス



低GWP
環境対応型溶剤



EUV露光用フォト
マスクブランク

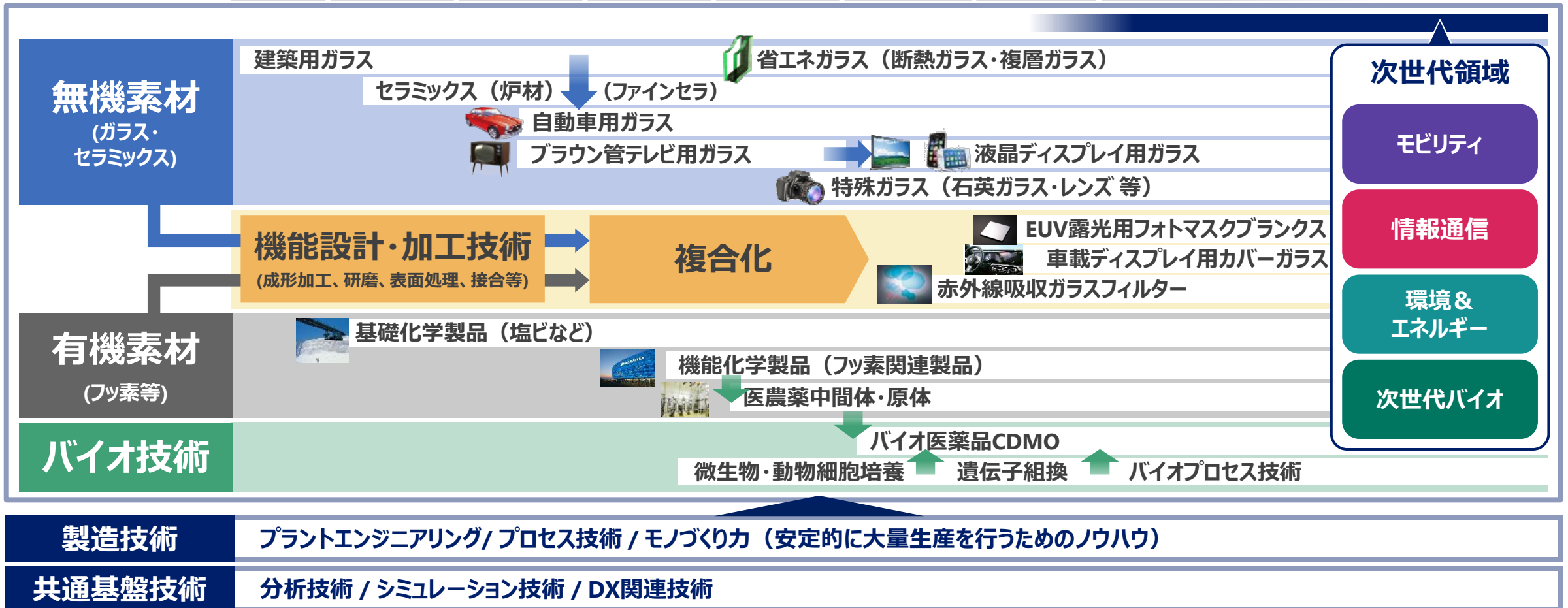


窓を基地局化する
ガラスアンテナ

AGCの技術的強み

独自の優位性を持つ材料技術（無機・有機）、高機能化を実現する設計・加工技術、ブラックボックス化された製造技術（ガラスプロセス、化学プロセス、バイオプロセス）、共通基盤技術

1907年 > 1910年代 > 1950年代 > 1970年代 > 1990年代 > 2000年代 > 2010年代 > 2020年代～



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 **2030**

コーポレート・ トランスフォーメーション 第一章

既存事業を「コア事業」、
成長分野での新事業群を
「戦略事業」と定義し、
両利きの経営を推進

コーポレート・ トランスフォーメーション 第二章

事業ポートフォリオ改革の
方向性を明確にし、
さらに加速することを宣言

2030年のありたい姿

独自の素材・ソリューションの
提供を通じて**サステナブルな**
社会の実現に貢献するとともに
継続的に成長・進化する
エクセレントカンパニーでありたい

—— 全社戦略 ——

**コア事業と戦略事業を両輪として、最適な事業ポートフォリオへの転換を図り、
継続的に経済的・社会的価値を創出**

コア事業

各事業の競争力を高め、強固で長期安定的な
収益基盤を構築



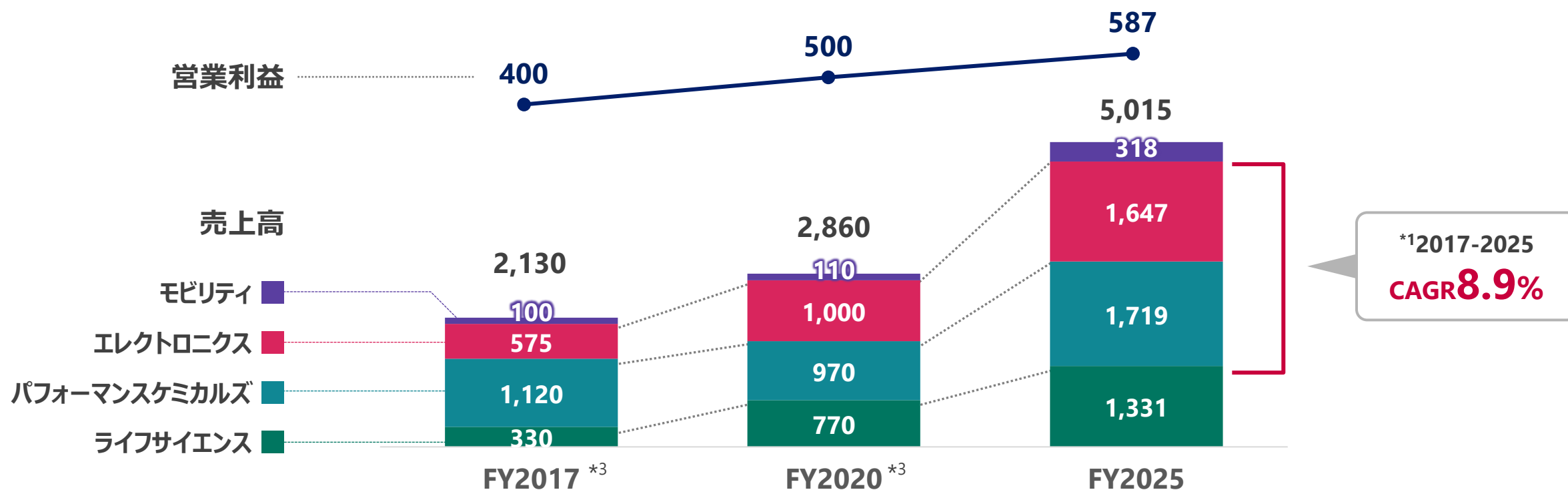
戦略事業

高成長分野において、自社の強みを活かし、
将来の柱となる高収益事業を創出・拡大



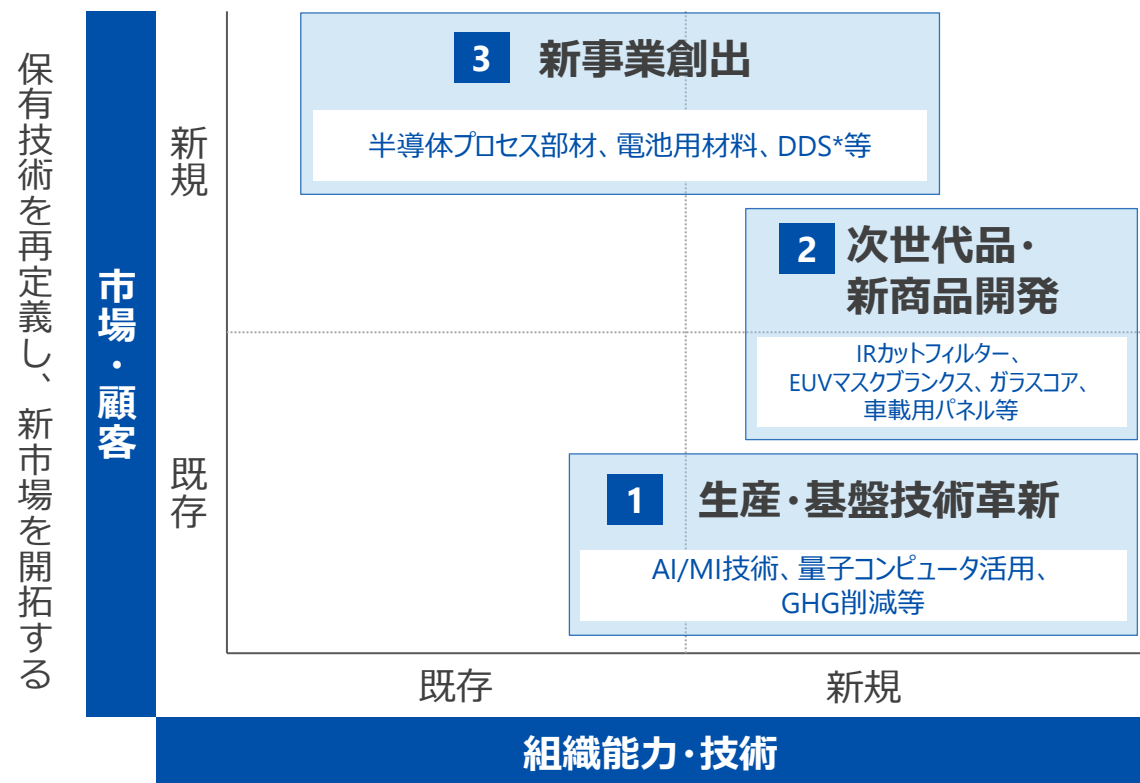
- 戦略事業の売上高は2017年比約2.4倍
- 半導体関連事業を含むエレクトロニクスとパフォーマンスケミカルズの売上高成長率は平均8.9%^{*1}

戦略事業^{*2} 売上高・営業利益 推移 (億円)



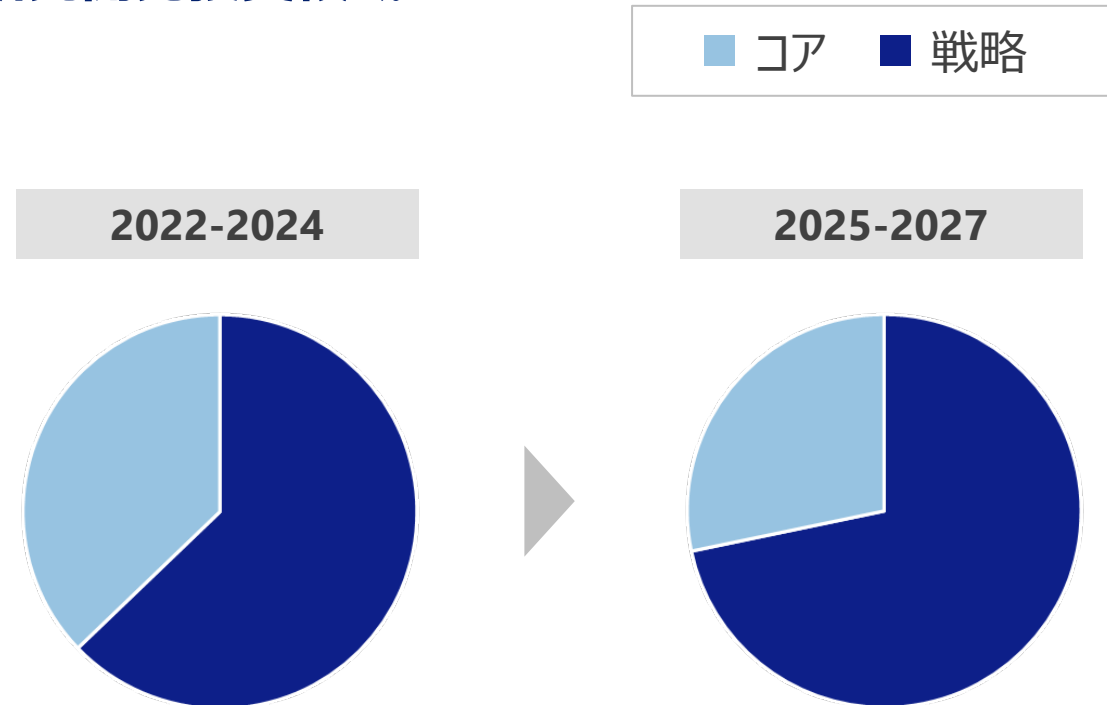
^{*2} 24年2月に改定した戦略事業の新定義を適用 ^{*3} FY2017とFY2020の売上高・営業利益は概算値 ※ ^{*2}^{*3}により過去に公表した数値と一部異なる

- 技術開発でポートフォリオ転換の加速に貢献
- 市場軸と技術軸で開発領域を選定し、研究開発投資における戦略領域の比率を高めていく



生産・基盤技術を革新し、お客様と共に新商品を開発する

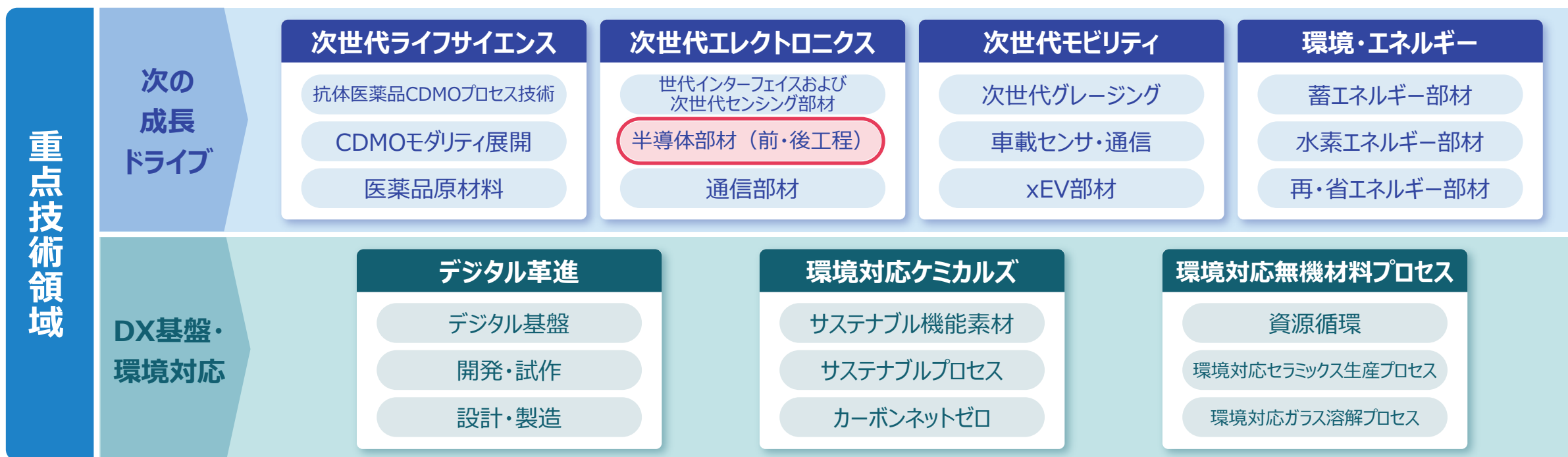
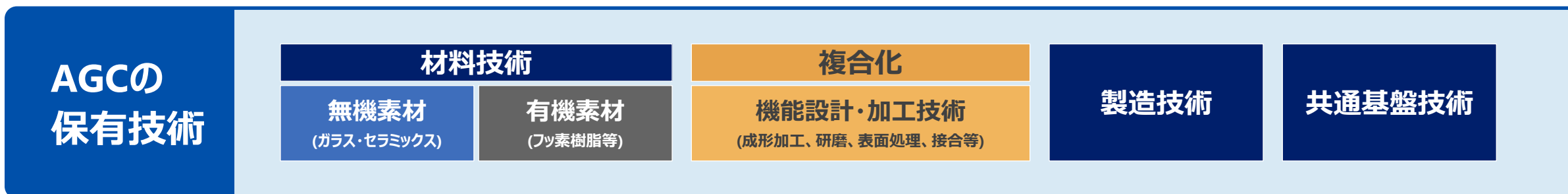
研究開発投資領域



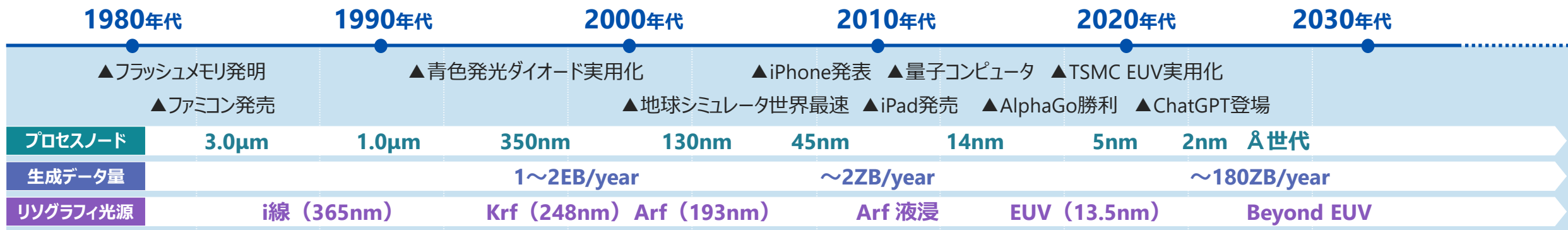
*DDS: Drug Delivery System (薬剤を体内で必要な部位に、必要な量、必要な時間作用させるように工夫を施す技術)

7つの重点技術領域と注力分野

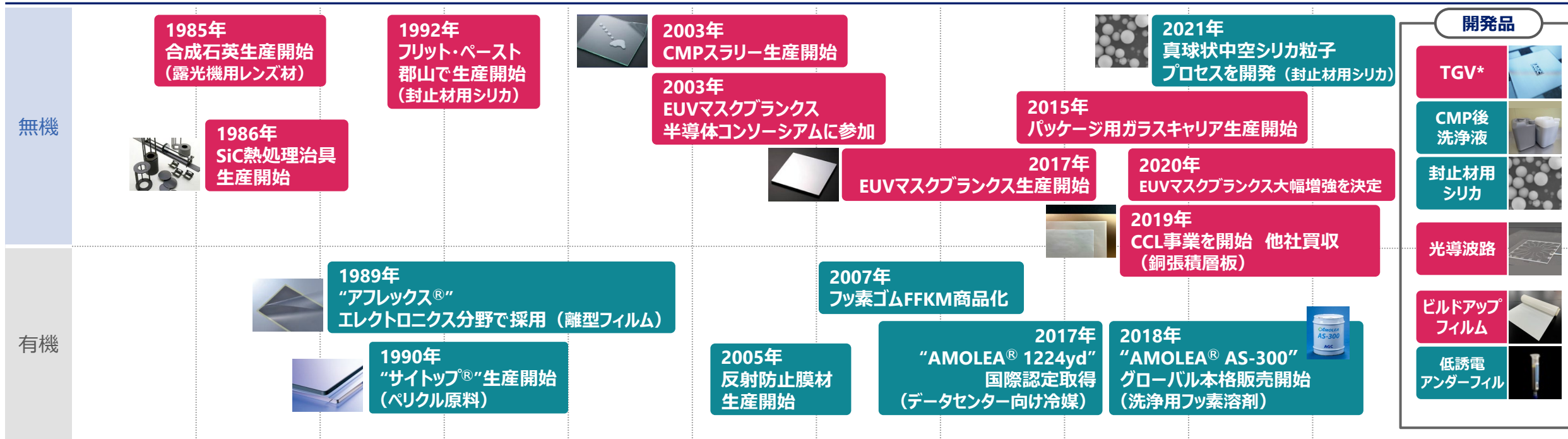
- 7つの重点技術領域とそれに対応する21の注力分野を選定



半導体関連技術開発の変遷



AGCグループの製品



*TGV (Through Glass Vias) : 微細孔付きガラス基板

半導体製造工程別製品ラインナップ

- 半導体分野においても多様な先端素材製品を提供し、高シェアを獲得
- 今後は成長領域であるパッケージング材にも注力

半導体関連製品

■ エレクトロニクス ■ パフォーマンスケミカルズ



*1TGV (Through Glass Vias) : 微細孔付きガラス基板 *2RCC (Resin Coated Copper) : 樹脂付き銅箔

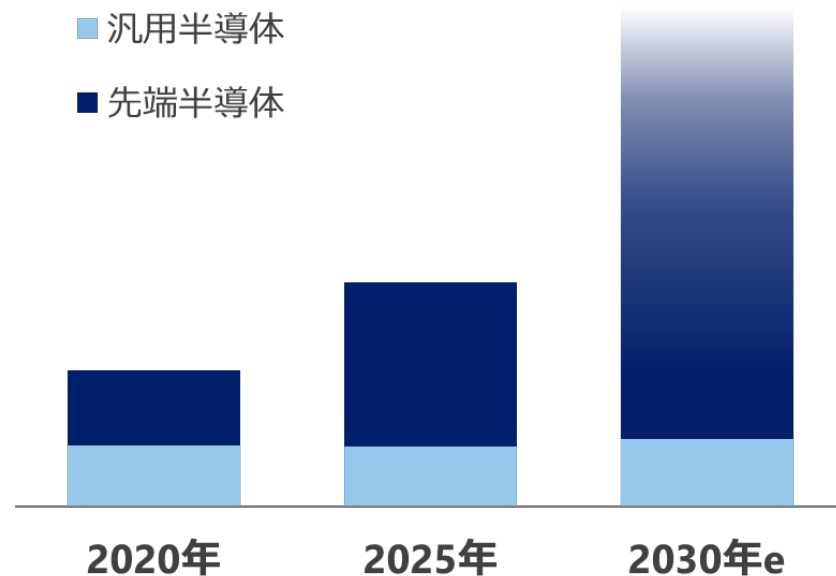
半導体関連事業：エレクトロニクス

素材、加工、設計・評価技術の組み合わせで AGC独自のソリューションを提供

		素材	加工	設計、評価
AGCの技術	無機	高純度ガラス、セラミクス	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高精度粉砕・分散・研磨 ■ 高精度コーティング、パターニング ■ 微細化、高アスペクト対応のレーザー、モールド 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 組成設計、光学設計 ■ 高性能検査機 ■ お客様工程を想定した独自のシミュレーション技術
	有機	フッ素樹脂、ポリマー、フッ素系溶剤		
	製品例	CMPスラリー	無機 + 有機	砥粒合成 + 分散
マスクブランクス		無機 (超低熱膨張硝材)	超平坦研磨 + 成膜 (コーティング)	ガラス組成設計 + 膜構造設計 + 欠陥検査
CPO (関連部材)		有機 (ポリマー) + 無機 (ガラス)	フォトリソグラフィ + エッチング	光学設計 + 光学特性評価

- 先端半導体向け部材に注力、今後はパッケージング用部材の売上拡大を目指す
- リーディングカンパニーとのパートナーシップ強化、先回りした技術開発と生産環境整備

電子カンパニーの半導体関連事業の売上高推移



既存の半導体
前工程用部材

半導体製造
装置用部材

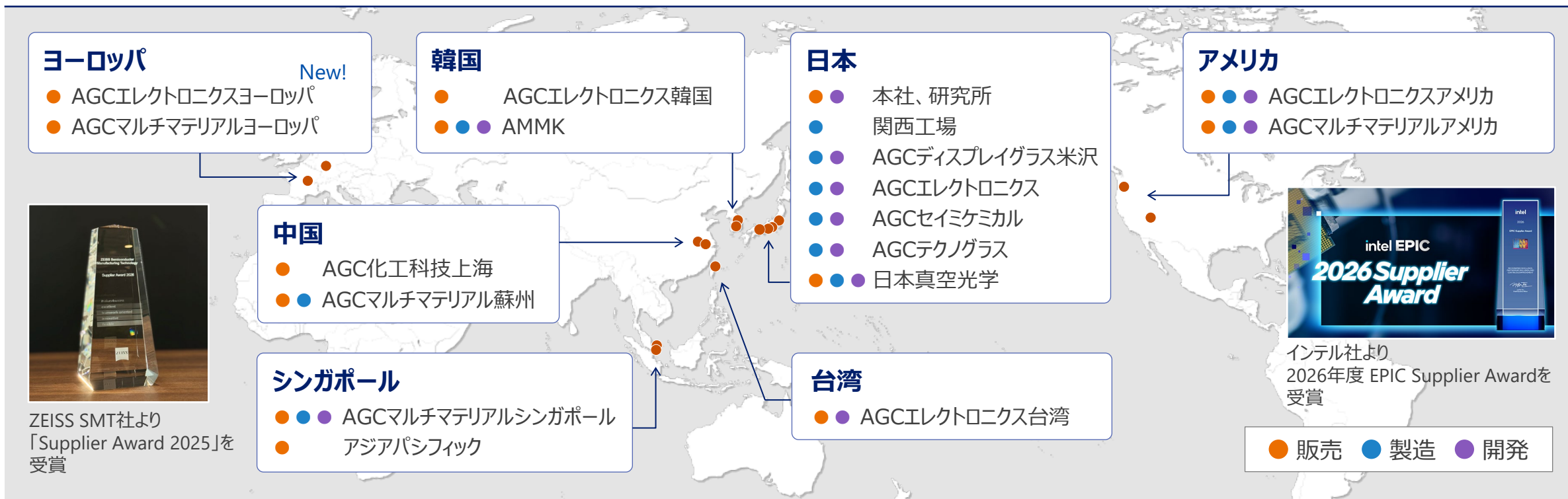
後工程
(パッケージング)
向け新製品

- リーディングカンパニーとのパートナーシップ強化
- 次世代品開発に注力し、先端品のシェア維持、向上

- 有機、無機の組み合わせによる複合部材を提案
- 隣接レイヤーを含めて最適化された“ソリューション提案”
- オープンイノベーションによる開発の加速

エンドユーザー、リーディングカンパニーとの関係を強化し、最先端、次世代に注力

- アメリカ、台湾、韓国、中国、ヨーロッパに拠点をもち、エンドユーザーに直接コンタクト
- ソリューション提案により次世代品をタイムリーに供給
- 電子カンパニーと化学品カンパニーが連携し、半導体分野での相乗効果を創出

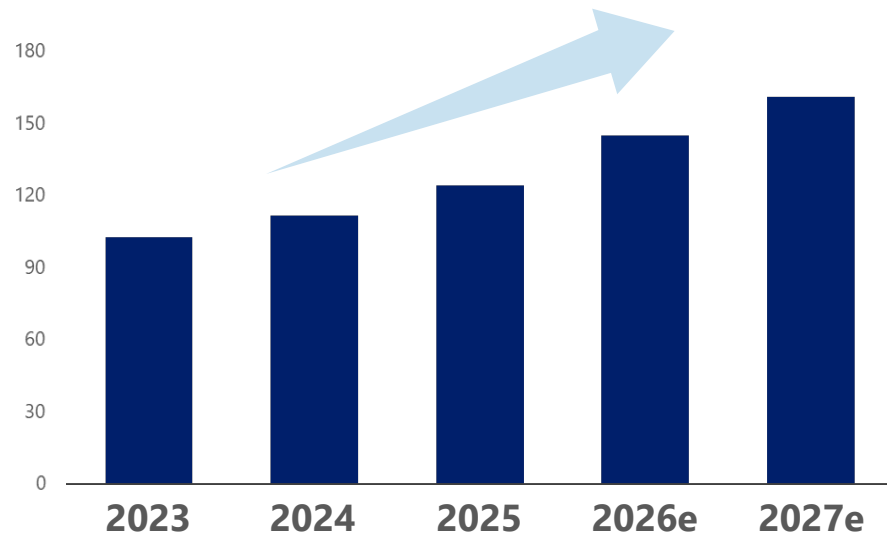


市場概観

- 半導体市場はAI・データセンターがけん引
- 大手先端半導体メーカーでは高水準の投資が続いており、製造装置市場は中期的に堅調に推移する見通し

半導体製造装置市場 *1 (単位：10億ドル)

市場成長



強み

- 長年培ってきたガラス・ケミカル・セラミックスの技術・研究開発を元に製造
- ArF露光装置用合成石英レンズ材でシェア1位
その他半導体プロセスの光学部品や、様々な光学部材などに採用
- 深紫外から赤外までの高透過性・高い光学的均質性・高レーザー耐久性

戦略

- 露光装置用レンズに適した特性を武器に高シェアを維持
- 半導体製造装置用部材の需要拡大を捉えた事業成長

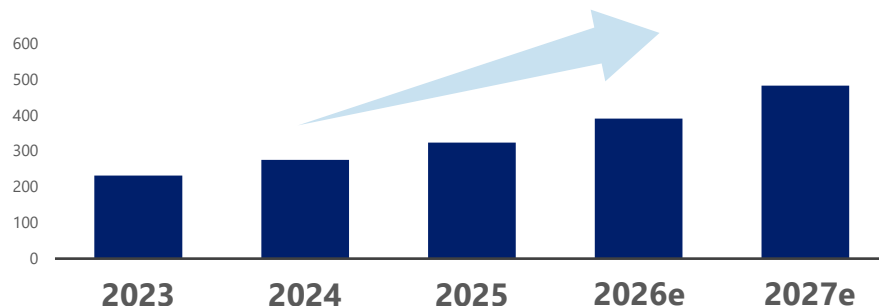


市場概観

- 出荷台数の増加とともに、EUVマスクブランクスの使用も増加

EUV露光装置出荷台数 *1 (単位：台)

出荷台数



- 露光機のスループットや解像度を向上できる次世代品を、半導体デバイス世代・露光機のモデル毎に開発

技術開発

デバイス世代	露光機	AGCの開発状況
□ジック 7~2nm DRAM D1Z~D1D	Low NA (NA0.33)	開発完了
□ジック 1.4~0.7nm DRAM D0X~	High NA (NA0.55)	開発中
□ジック <0.7nm	Hyper NA (NA>0.7)	開発中

強み

- 硝材から研磨・成膜まで一貫生産する“世界で唯一”のブランクスメーカー
- お客様要望に対する柔軟な対応力、お客様への技術提案力・サポート力
- 自社内の膜構造設計能力

戦略

- 市場成長に合わせ、今後も積極投資を継続
- 高い技術力を武器に、先端ノード向けの次世代ブランクスを開発を推進



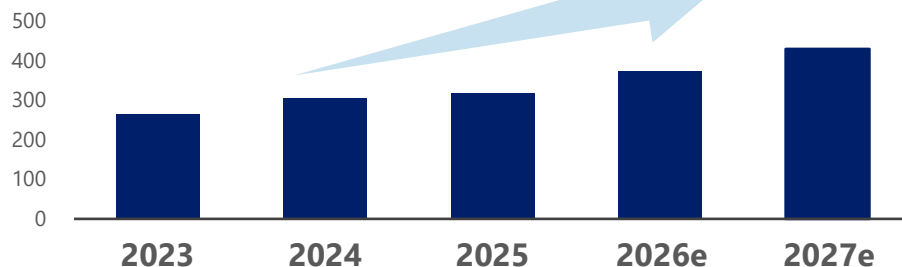
グローバル市場に
おける二強体制の一角

市場概観

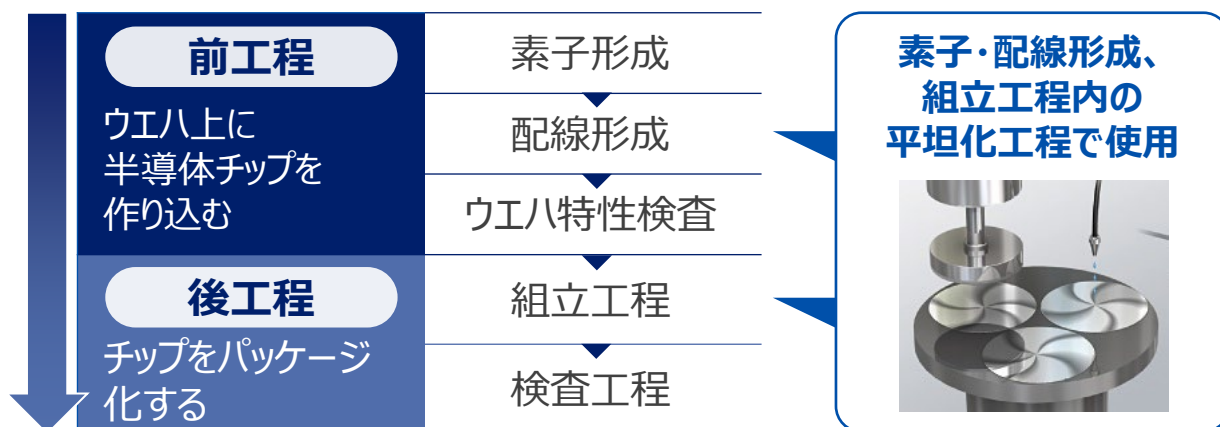
■ 半導体市場の成長とともにセリアスラリー市場も拡大

セリアスラリー市場*1 (単位: 百万ドル)

市場成長



半導体製造プロセスにおけるCMPスラリーの使用シーン

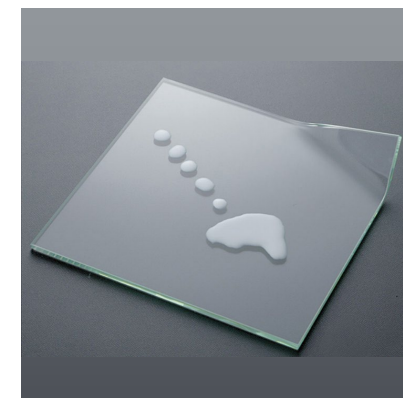


強み

- 原料砥粒からスラリーまで一貫生産できる技術開発力
- お客様のデザインルール、プロセスに対応した“高品質のスラリー”+“ソリューション”を提供
- 自社の技術とお客様のニーズをすり合わせる柔軟な対応力と品質安定性

戦略

- セリアスラリーでのリーディングポジションを維持
- 新たな用途（3D実装*2等）への拡販



市場概観

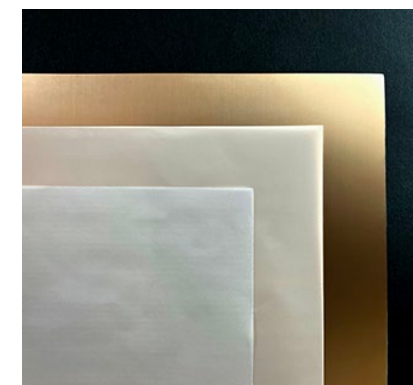


強み

- 幅広い製品ラインナップを保有
- 低誘電損失樹脂を中心とした材料開発技術、樹脂コーティング技術、電気特性評価技術
- 化学品関連技術を利用した低誘電損失

戦略

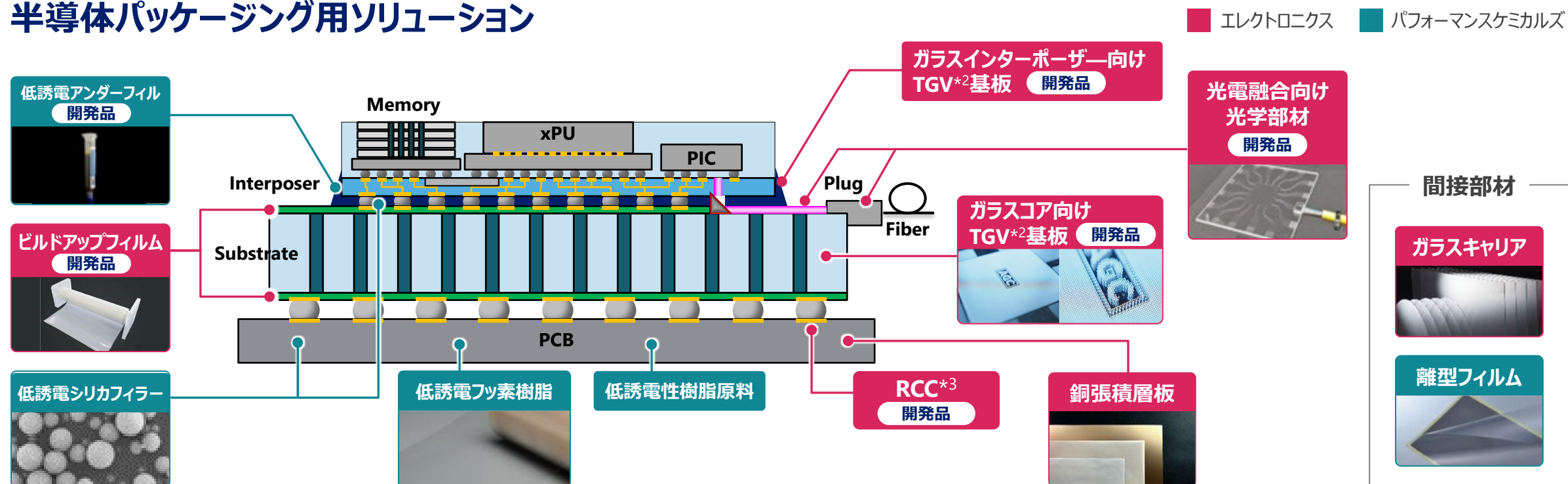
- AIデータセンター向け用途への販売拡大
- 高速通信や自動車、航空・宇宙用途など幅広い事業に展開



半導体パッケージング分野への取組み

- 前工程の微細化だけでなく、実装・パッケージングを含む後工程も組み合わせて差別化される時代
- 前工程中心の材料ポートフォリオに加え、全てのレイヤー*1に対し、電子カンパニーと化学品カンパニーのアセットを活用し幅広い提案を展開
- 隣接レイヤーを含めて最適化されたパッケージ全体を成立させる“ソリューション提案”を推進

半導体パッケージング用ソリューション



半導体関連事業：パフォーマンスケミカルズ

- フッ素製品は複数の優れた特性を同時に発揮でき、特に**要求水準の高い半導体分野においては他素材では代替が困難なポジションを占める**

AGCのパフォーマンスケミカルズ

成り立ち

- 塩水の電気分解を起点とする一貫生産の中で、塩素、フッ酸、天然ガス等の自社資源を活用し、競争力ある事業基盤を確立
- 1960年代以降の産業高度化に伴う高機能材料需要の拡大を背景に、フッ素化学品事業を展開

強み

①	フッ素製品合成技術	取り扱いの難しいフッ素製品の 合成技術を基盤とした開発・量産技術力
②	サプライチェーン	塩水の電気分解を起点に、自製するフッ酸、*TFEを介し、フッ素製品に至るまでの、 強固でコスト競争力を有するサプライチェーン
③	資源調達リサイクル	廃棄されていたフッ素を回収し、「循環蛍石™」として再資源化安定調達とサステナビリティの両立を目指す
④	グループシナジー	半導体メーカーのサプライチェーン中核を担う 電子カンパニーほか、関係部門とのシナジーを強み とし、材料から部材・プロセスまでを一体で提案

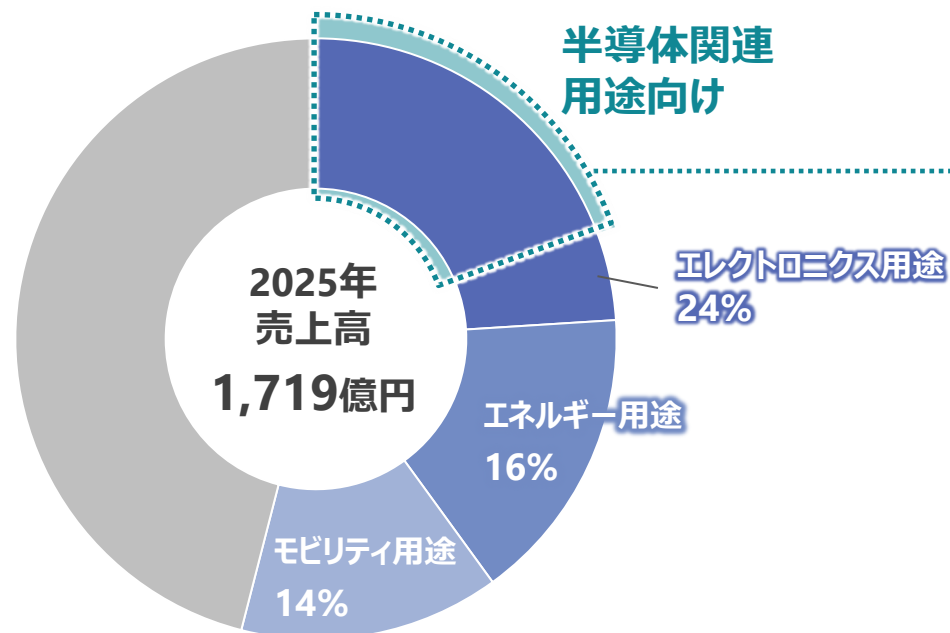
半導体分野のフッ素製品用途例と要求特性

	耐熱性・耐寒性	耐薬品性	耐候性・耐久性	撥水撥油性	機械的特性	電気特性	光学特性
製造装置用 フッ素樹脂・ゴム	●	●	●				
離型フィルム	●		●	●	●		
ペリクル原料	●	●	●	●		●	●
熱媒体	●	●					
パッケージング材	●			●		●	

半導体領域の戦略（パフォーマンスケミカルズ）

- フッ素製品の差別化された合成技術と強固なサプライチェーンで培った開発・量産技術力、コスト競争力をベースに、拡大する半導体関連用途向け部材の需要を取り込む
- お客様とのつながりと、電子カンパニーほかAGCグループ内のシナジーを活かし、顧客のニーズに合った半導体プロセス材料をスピーディに開発する

パフォーマンスケミカルズ*1の 半導体関連用途向け売上高比率（イメージ）



従来からフッ素樹脂・ゴムが使用される領域

A 半導体製造 装置用材料

耐熱性・耐薬品性などの差別化技術と新設能力*2を活かして拡大する需要に応える

<AGCのフッ素樹脂・ゴムの特徴>

- 市場ニーズ（耐熱性・耐プラズマ性等）にマッチした製品をタイムリーに開発・供給
- クリーン製造環境の継続的改善による、低金属、低異物な高純度材料の安定供給
- 希少資源であるフッ素の有効活用のため、循環蛍石™*3の利用を一部で実施

今後事業を拡大していく領域

B 半導体 プロセス用材料

これまでに構築した顧客との関係を基盤に、半導体プロセス材料の領域拡張および高速通信材料市場への展開加速

- 低GWP化に加え、AI半導体やAIデータセンターで要求される微細化・高速通信に対応する半導体プロセス材料・パッケージング材料を開発

*1 戦略事業のパフォーマンスケミカルズ *2 千葉工場におけるフッ素化学品の増強設備

*3 循環蛍石™：廃棄されていたフッ素を回収し、「循環蛍石™」として再資源化する試み。
AGCは循環フッ素社会の形成を目指しています。

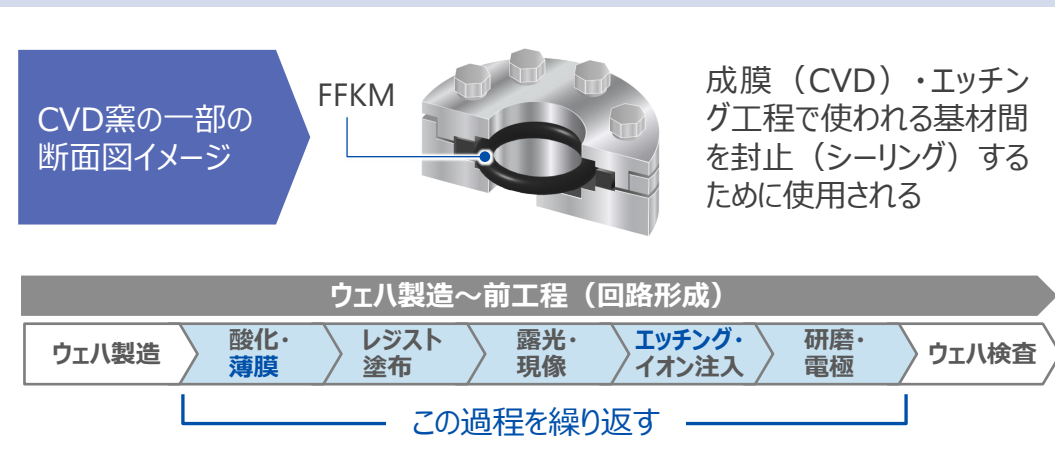
① 製造装置用フッ素樹脂・ゴム (AFLAS® FFKM) 1/2

A 半導体製造
装置用材料

市場概観

FFKMとは	<ul style="list-style-type: none">■ パーフルオロエラストマーの通称■ 全ての水素原子がフッ素に置き換えられた完全フッ素化構造をもつ高品質なフッ素ゴム
用途	半導体製造装置内のシーリング材
求められる特性	<ul style="list-style-type: none">■ 酸、塩基、溶剤、酸化剤などあらゆる化学物質に対する耐性■ 高温環境での長期間弾性と密封性能
市場成長	<ul style="list-style-type: none">■ 半導体需要増と共にFFKM需要は年々増加■ 需要量は装置稼働率に左右されるが、安定した交換需要が見込める (エッチング工程では過酷なプラズマ環境のため四半期に1度の交換が必要)

FFKM使用箇所



サプライチェーン



① 製造装置用フッ素樹脂・ゴム (AFLAS® FFKM) 2/2

A 半導体製造
装置用材料

☆ 強み

- 極めて過酷なプラズマ環境下でも安定して使用できる、**業界トップクラスの高耐熱・高耐プラズマ性能**
- **耐薬品性を発揮するPO系*FFKMを、乳化剤、フッ素系重合溶媒不使用で他社に先駆け商業化**

🕒 今後の取り組み

1 技術トレンドへの対応

- 半導体の微細化トレンドに従い、製造プロセスもますます過酷化
- FFKMシーリング材も一層の**耐薬品性・耐熱性・耐プラズマ性が求められている**

FFKM用途 ▶ 半導体製造装置、工場、食品、石油・ガス産業向け

AGCのFFKMラインナップ

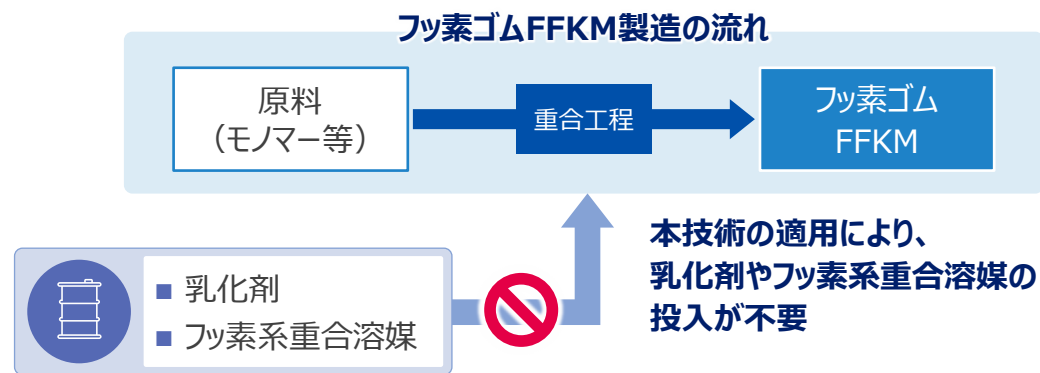
*1PO系 FFKM

		耐熱温度				
		~200°C	200°C	250°C	300°C	300°C~
性能	標準仕様		PM-1100	PM-3000	PM-5000 PM-5500	
	耐プラズマ性	今後の 開拓領域		CP-4010 PM-3500	CP-7000	今後の 開拓領域
	低融点 (加工性に優れる)		PM-1200			

2 新たな市場ニーズへの対応

- 廃棄されていたフッ素を回収し、「循環蛍石™*2」として再資源化
業界トップクラスのリサイクル水準を実現し差別化を図る
- 乳化剤、フッ素系重合溶媒を使用しないFFKMを開発

革新的なポリマー製造技術 (Surfactant Free & Fluoro Solvent Free)



*1PO系：有機過酸化物を使用してゴム分子を繋ぐ加工。
300°C未満における耐熱性やその温度域での高耐薬品性が特徴。

*2 UL2809のマスバランス方式*2 による算定により、AFLAS® FFKMに含まれるフッ素成分は、算定上100%が循環蛍石™
(リサイクル蛍石) 由来 <https://www.agc-chemicals.com/jp/ja/company/vision/innovationstory/vol02/index.html>

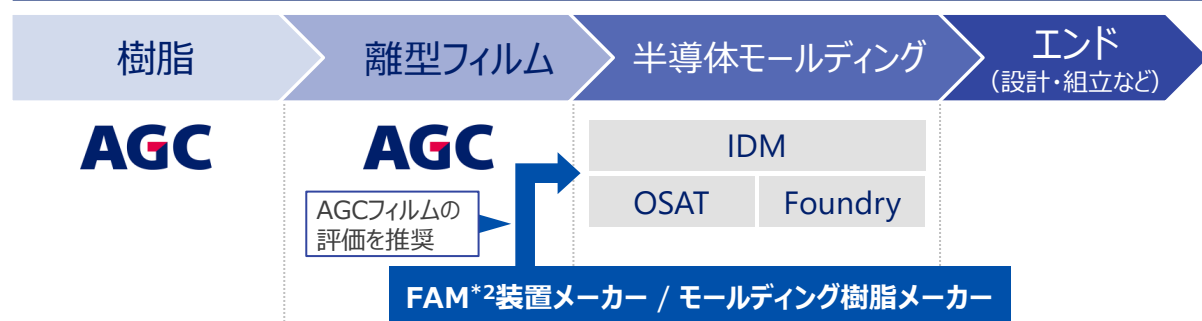
② ETFE製 離型フィルム (Fluon® ETFE FILM / アフレックス®) 1/2

B 半導体
プロセス用材料

市場概観

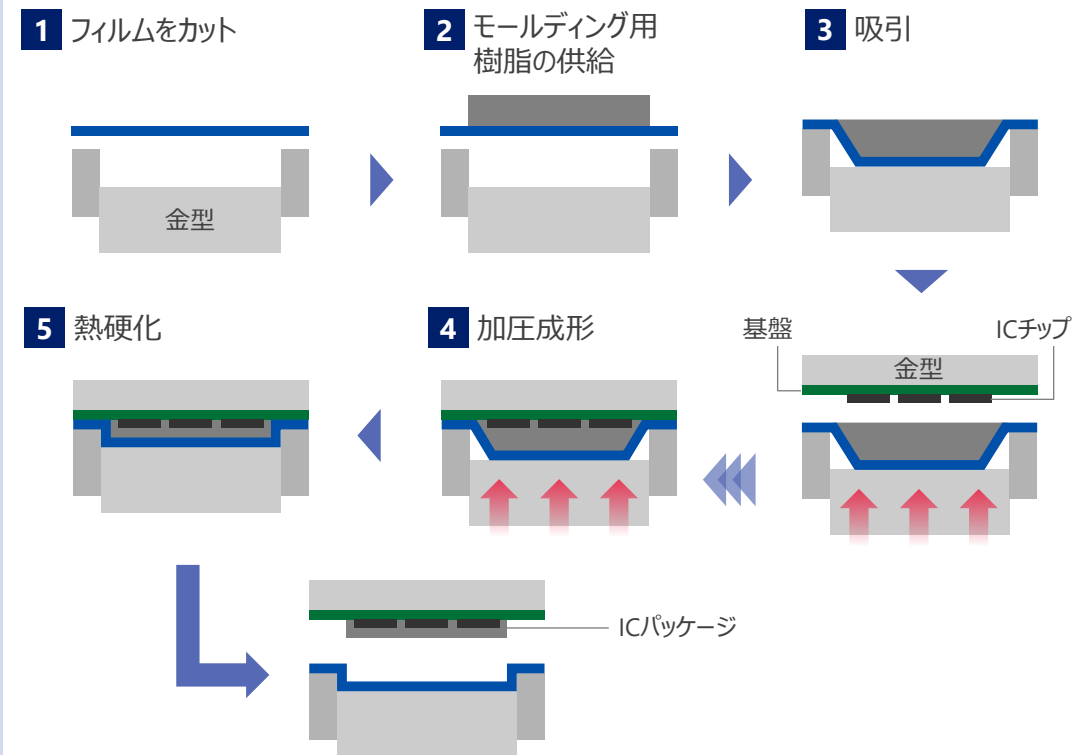
用途	半導体後工程のモルディング工程における離型フィルム（消耗品）
求められる特性	離型性、金型追従性、耐熱性、純度、クッション性
市場	<ul style="list-style-type: none"> ■ AGCシェア 世界1位*1 ■ 半導体の生産数量に相関。市場成長に合わせて数量増加見込み ■ HBM（次世代半導体メモリ）でも使用

サプライチェーン



離型フィルムの使われ方のイメージ図

コンプレッション モルディング工程



*1販売ベース/当社調べ *2Film Assisted Moldingの略。半導体パッケージングにおいて、フィルムを使って樹脂モルディングを行う高精度な装置

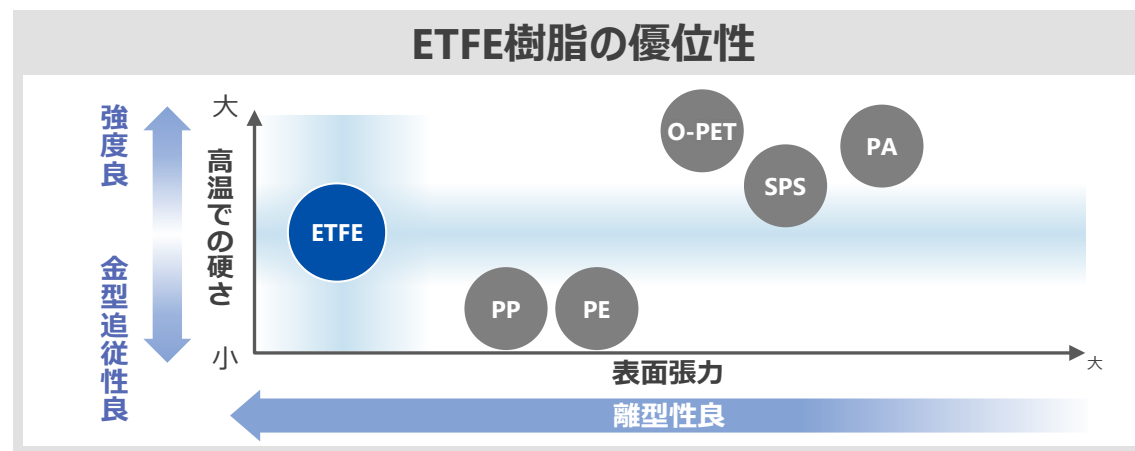
② ETFE製 離型フィルム（Fluon® ETFE FILM / アフレックス®） 2/2

B 半導体
プロセス用材料

- 独自の樹脂設計・成形加工技術の融合により、**半導体離型フィルムの世界No.1シェアを維持**
- パッケージの大型化が進む次世代モールドイングプロセスへの展開も推進

☆ 強み

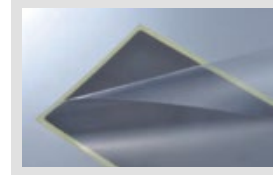
- 他素材では両立が難しい、強度・金型追従性・離型性を同時実現。業界デファクトスタンダードを確立
 - ➡ カスタマイズ対応が可能
- 世界No.1のETFE樹脂サプライヤー。半導体用途で、原料樹脂からフィルムまで一貫開発・生産できる唯一の企業
- 装置メーカー・半導体メーカーとの強固な関係性
 - ➡ モールドイング工程は変更管理が厳しく、競争への切替ハードルが極めて高いため高シェアを維持



🕒 今後の取り組み

- 既存（汎用半導体）市場での高シェア維持
- HBM等の最先端パッケージ向けの開発強化
- AGC独自の帯電防止フィルムの開発・ラインナップ拡充

最終製品イメージ



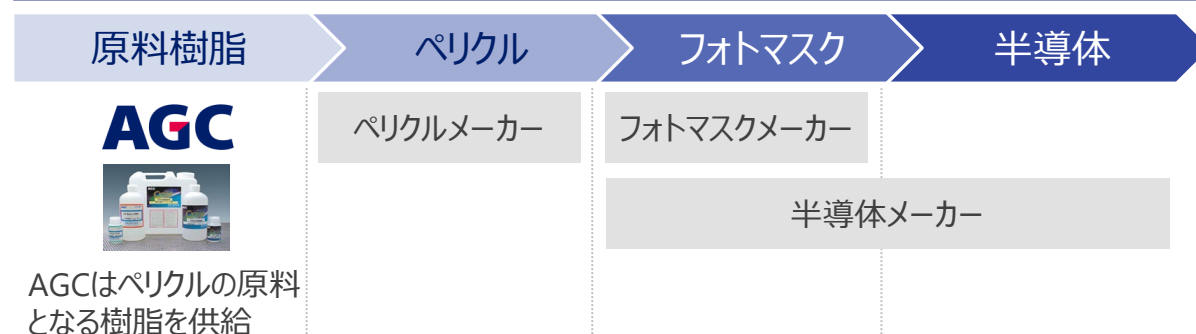
- ➡ 静電破壊対策が必須となる先端用途で採用

③ ペリクル原料（サイトップ™） 1/2

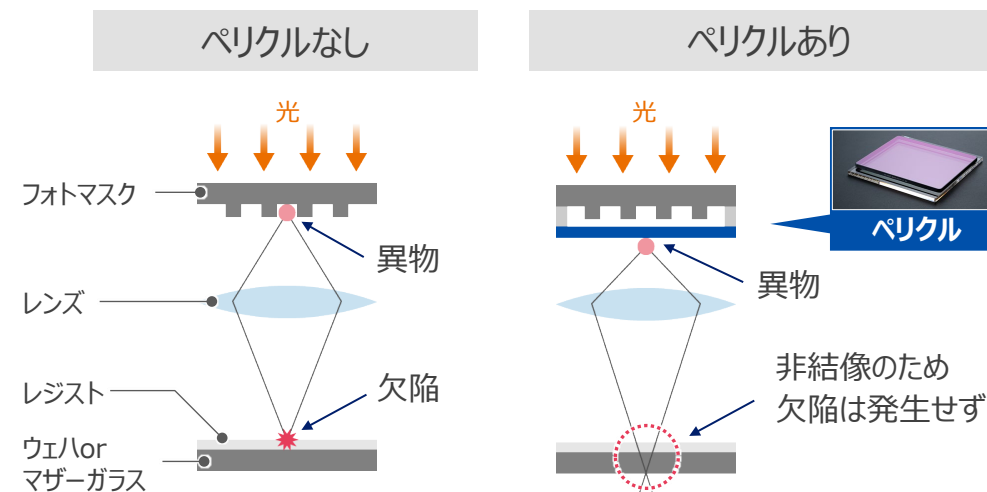
市場概観

用途	<ul style="list-style-type: none">■ フォトマスクのカバーとして使用される保護膜■ 半導体製造の露光工程でフォトマスクに異物が付着しシリコンウエハに結像することを防ぐ
求められる特性	紫外線耐久性、紫外線透過性
市場成長	<ul style="list-style-type: none">■ ペリクル市場は、半導体製造設備の拡張とフォトマスク需要の増加に連動して成長■ 成熟した半導体製造分野*でも、主要なロジック半導体・メモリー半導体の長期稼働を背景に、緩やかながら堅調に成長

サプライチェーン



ペリクルの原理のイメージ図



マスク上に付着した異物は、露光時にウエハ上に転写され、パターン欠陥を引き起こす

ペリクルの表面に付着した異物は、露光時にウエハ上に転写されず、パターン欠陥を回避できる

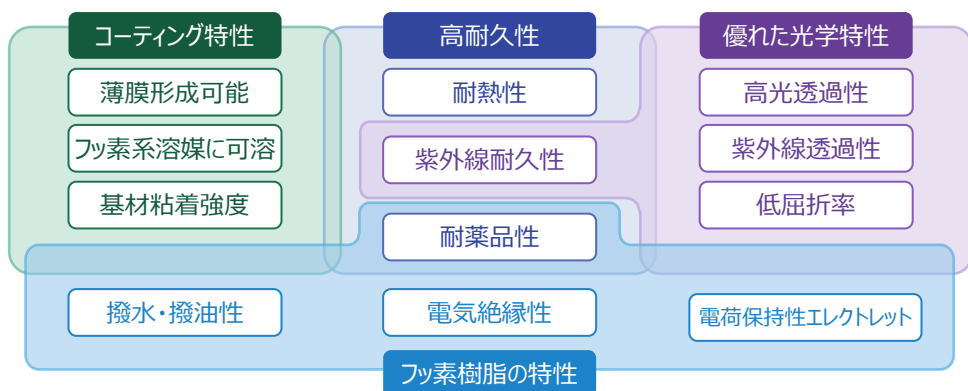
*製造技術が確立し、家電・産業機器・自動車向けなど、長期的に安定した需要を持つ分野で使われる半導体

③ ペリクル原料（サイトップ™） 2/2

- サイトップは、エレクトロニクス・情報通信・ライフサイエンスなど、幅広い分野で使用
- 高耐久性と優れた光学特性を活かし、**主要な ArF/KrF 用ペリクル原料向けに、実質的に代替品のない地位を確立**

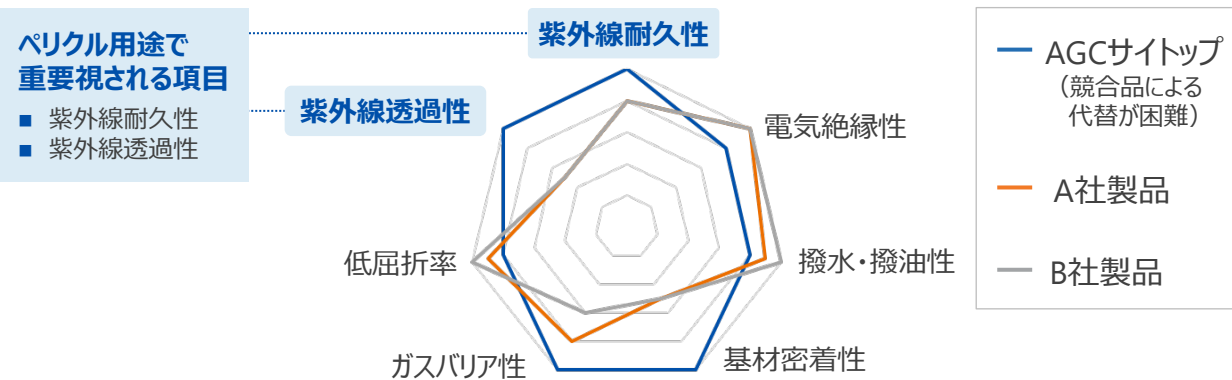
☆ 強み

- 溶液タイプなので、薄膜コーティングが可能
- アモルファス（非晶質）構造のため、透明性が高い
- 「電気絶縁性」「撥水・撥油性」「紫外線透過性」「耐薬品性」等の特性を同時に実現可能



フッ素競合品との差異（イメージ）

- 優れた薄膜形成技術と耐候性・信頼性を備えたペリクル原料を実現
- フォトマスクおよび露光プロセスとの高い親和性があり、競合品による代替が困難



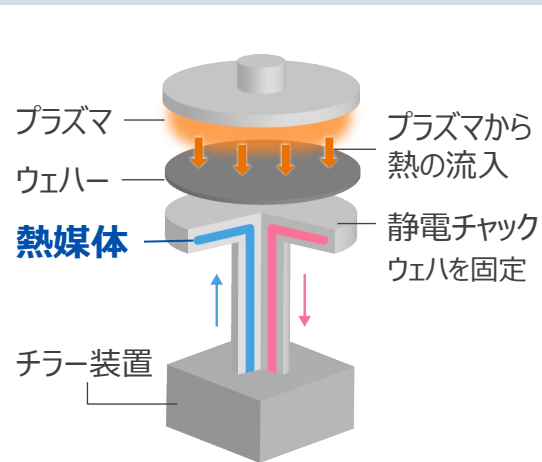
④ 半導体向け熱媒体 AMOLEA® AF-164（開発品） 1/2

B 半導体
プロセス用材料

市場概観

用途	半導体の製造工程(成膜、エッチング、イオン注入等)での、精密な温度制御
求められる特性	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不燃性、高い熱伝導性、熱安定性、電気特性 ■ 低GWP

エッチング工程での熱媒体の使用イメージ



熱媒体を利用しなければならぬ理由

- 大量の熱が局所的・瞬間的に発生
 - 工程数増加・構造微細化により、温度制御精度が歩留まり・デバイス性能に直結
- ➡ 精密温調が不可欠

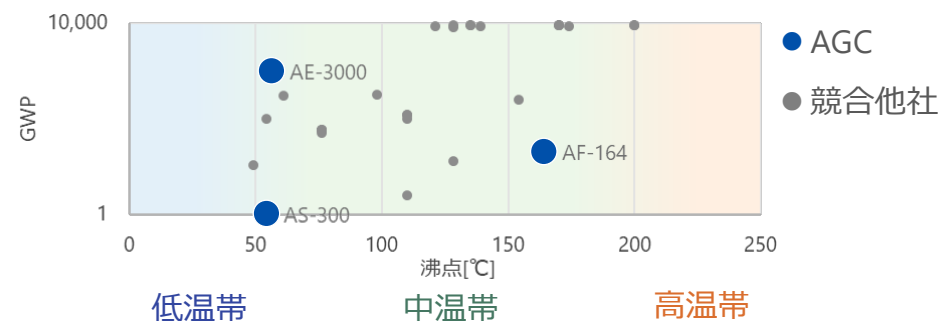
市場規模

AGCは需要規模の大きい中温帯領域をターゲットに開発を推進

熱媒体として使用されるフッ素系液体の製品群

市場規模 300億円 (AGC推定)

用途 半導体製造、化学品製造、発電、データセンター他



市場成長

半導体向け熱媒体市場は、AIサーバー向けが牽引し、成長率は10%/年以上

④ 半導体向け熱媒体 AMOLEA® AF-164（開発品） 2/2

B 半導体
プロセス用材料

- フッ素樹脂・ゴムを通じて構築した装置メーカーとの関係性と、冷媒や洗浄剤の開発・量産化で培った技術を背景に、競争優位性を備えたAMOLEA® AF-164を新たに開発
- 今後も半導体製造プロセスにおける更なる用途探索により、事業拡大を図っていく


AF-164

- 単一化学物質で沸点164℃のフッ素系溶剤
- 半導体製造エッチング工程で使用

☆ 強み

- AF-164のみで広範な温度域での利用が可能。複数熱媒の使い分けが不要となり、**お客様の装置運用・調達負荷を軽減するとともに、トータルコスト低減に寄与**
- GWPが低く環境負荷が小さい
- 川上原料から日本国内生産しており地政学リスクが低い

競合他社製品との比較

製品名	メーカー	中温帯の熱媒体での使用可能温度	GWP (環境配慮)	生産国 (地政学リスク)
AF-164	AGC	◎ 	◎	◎
-	B社	○ 	×	×
-	C社	○ 	○	○
-	D社	○ 	○	◎
-	E社	×	◎	?

⑤ CMP後洗浄液（開発品） 1/2

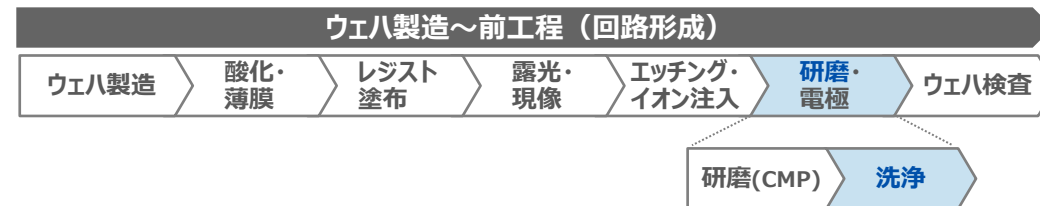
市場概観

用途	半導体前工程の研磨工程（CMP）後のウエハ表面に残留する微粒子や化学残渣を除去する洗浄液
求められる特性	高い洗浄性能、基板・配線材料への低ダメージ性
競合	半導体向けケミカルメーカー
市場成長	<ul style="list-style-type: none"> ■ CMPプロセスの拡大により、需要は堅調に増加 ■ 半導体の微細化を背景に、今後も安定成長の見込み

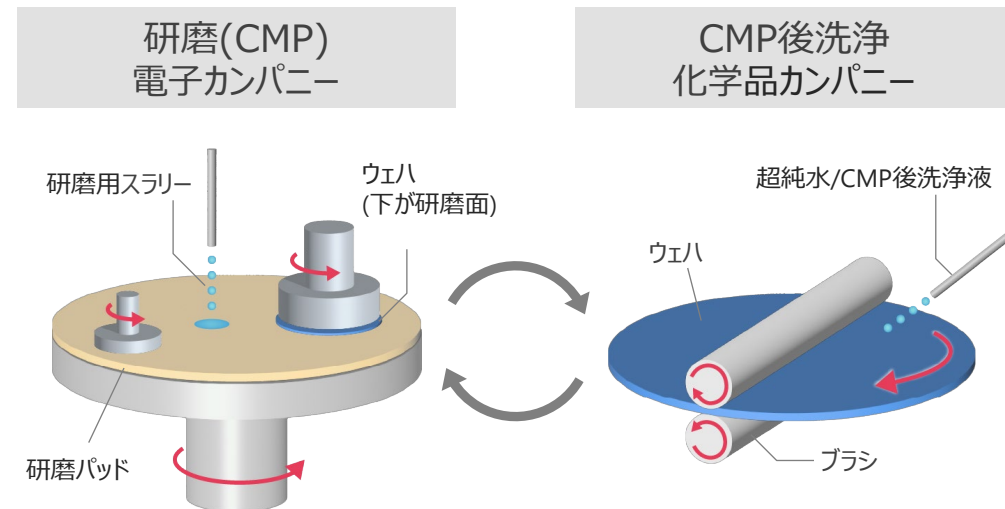
サプライチェーン



CMP後洗浄液の使用工程とイメージ図



CMP 工程でのトータルソリューション



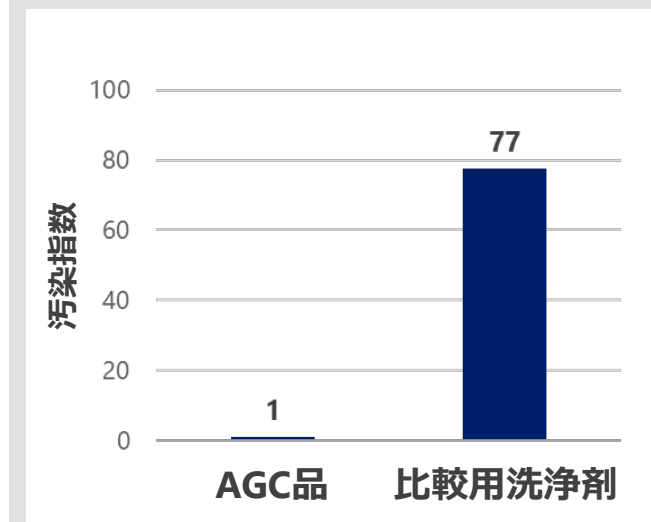
⑤ CMP後洗浄液（開発品） 2/2

- 電子/化学品カンパニーの連携により、CMPスラリーから後洗浄液までをカバーするトータルソリューションを提供
- 半導体関連企業が集積する台湾・新竹にケミカルズテクニカルセンター*を設置。顧客ニーズの把握から製品・サービス提案、新製品開発までを一体的に推進

☆ 強み

- セリア系CMPスラリーに特化した知見と技術蓄積を活かし、プロセス全体での競争優位を確保
- CMPスラリー特性を踏まえて設計
- 水や一般的な界面活性剤に比べ、**CMP工程後の洗浄に適した性能を発揮**

洗浄性能（AGC品を1とした時の相対値）



🕒 今後の取り組み

- セリア系CMP関連材料の技術基盤を活かしたトータルCMPソリューションの展開
- 先端ノード・先端パッケージ向け需要の取り込み
- 高付加価値・環境配慮型製品を軸とした安定的な成長



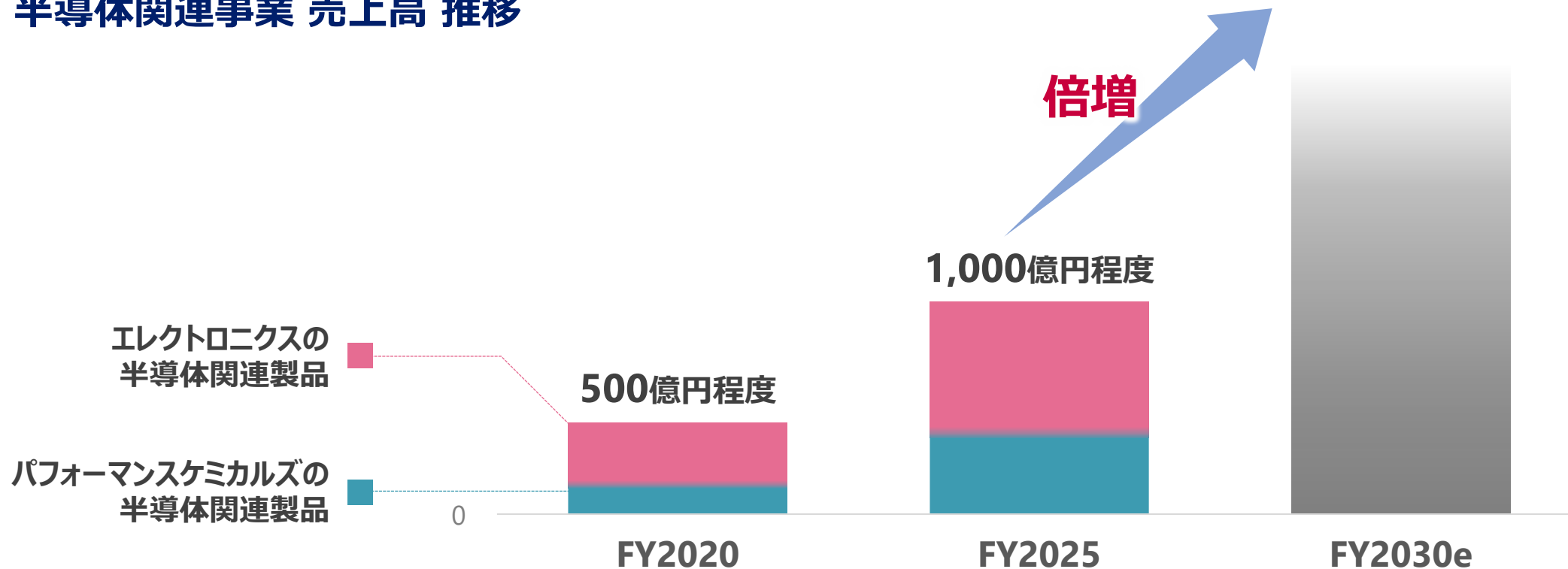
テクニカルセンターが入居する 新竹「台元科学園区」内ビル

まとめ

半導体関連事業の売上高推移

- AGCの総力をあげて、2030年までに売上高を2025年比倍増を目指す
- 既存製品は成長持続
- パッケージング材を中心とした新製品開発・上市にも注力

半導体関連事業 売上高 推移



END

AGC

Your Dreams, Our Challenge